

(19) KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

KOREAN PATENT ABSTRACTS

(11) Publication number: 1020020074716 A
(43) Date of publication of application: 04.10.2002

(21) Application number: 1020010014670

(71) Applicant: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

(22) Date of filing: 21.03.2001

(72) Inventor: HONG, UK SEON

(51) Int. Cl

H01L 21/762

(54) TRENCH ISOLATION STRUCTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR FABRICATING THE SAME

(57) Abstract:

PURPOSE: A trench isolation structure of a semiconductor device and a method for fabricating the same are provided to prevent a damage and a dent phenomenon of a tunnel oxide layer by using a silicon nitride layer liner buried by an isolation layer.

CONSTITUTION: A trench region and an active region are defined on a semiconductor substrate (111). A tunnel oxide layer(211) and a conductive layer pattern(120) are laminated on the active region of the semiconductor substrate(111). An inner wall of the trench region is covered by a silicon nitride layer liner(321). A region surrounded with the silicon nitride layer liner(321) and a gap region between conductive layer patterns are filled by an isolation layer (260). A sidewall of the conductive layer pattern(120) is contacted with an upper sidewall of the isolation layer(260). The silicon nitride layer liner(321) is buried by the isolation layer(260) and the conductive layer pattern(120). A thermal oxide layer(240) is inserted between the silicon nitride layer liner(321) and an inner wall of the trench region. A thermal oxide layer(250) is inserted between the conductive layer pattern(120) and the isolation layer(260). The Isolation layer(260) includes the first and the second isolation layer pattern(221,232). The first isolation layer patterns(221) is buried by the silicon nitride layer liner(321) and the second isolation layer pattern(232).

&copy; KIPO 2003

Legal Status

Final disposal of an application (application)

특2002-0074716

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁷
HD11 21/762

(11) 공개번호 특2002-0074716
(43) 공개일자 2002년10월04일

(21) 출원번호	10-2001-0014670
(22) 출원일자	2001년03월21일
(71) 출원인	삼성전자 주식회사
(72) 발명자	경기 수원시 팔달구 매단3동 416 홍득선
(74) 대리인	서울특별시서대문구홍제4동홍제원현대아파트104동703호 임창현, 권혁수

설명구 : 없음

(54) 반도체 장치의 트렌치 소자분리 구조체 및 그 제조 방법

요약

자기정렬 트렌치 소자분리 구조체 및 그 형성방법을 제공한다. 이 자기정렬 소자분리 구조체는 반도체기판의 소정영역에 형성되어 활성영역을 확장하는 트렌치 영역과, 활성영역 상에 차례로 적층된 터널산화막 및 도전막 패턴과, 트렌치 영역의 내벽을 덮는 실리콘질화막 라이너와, 실리콘질화막 라이너에 의해 둘러싸여진 영역을 차우면서 도전막 패턴의 축벽과 접촉하는 소자분리막을 포함한다. 실리콘질화막 라이너 및 소자분리막은 활성영역 상에 차례로 적층된 도전막 패턴 및 연마저자막 패턴과 자기정렬된 트렌치 영역을 형성한 후에, 트렌치 영역을 갖는 반도체기판 전면에 실리콘질화막 라이너층 및 제1 소자분리막을 형성하고, 제1 소자분리막을 삭각하여 트렌치 영역 내에 진공하는 제1 소자분리막 패턴을 형성함과 동시에 연마저자막 패턴의 표면 및 도전막 패턴의 축벽 상의 실리콘질화막 라이너층을 노출시키고, 노출된 실리콘질화막 라이너층을 삭각하여 제거하고, 제1 소자분리막 패턴 상에 도전막 패턴의 축벽과 접촉하는 제2 소자분리막 패턴을 형성함으로써 형성된다.

기초도

도10

형세식

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 소자분리 구조체 형성방법의 문제점을 설명하기 위한 단면도이다.

도 2a 및 도 2b는 또다른 종래의 소자분리 구조체 형성 방법의 문제점을 설명하기 위한 단면도들이다.

도 3a~도 9는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 자기정렬 트렌치 소자분리 구조체 형성 방법의 주요 단계를 나타내는 공정 단면도들이다.

도 10는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 자기정렬 트렌치 소자분리 구조체를 나타내는 단면도이다.

본명의 간단한 설명

본명의 목적

본명에 속하는 기술 및 그 보야의 종래기술

본 발명은 반도체 장치 및 그 제조 방법에 관한 것으로서, 특히 반도체 장치의 트렌치 소자분리 구조체 및 그 제조 방법에 관한 것이다.

반도체 소자의 고집적화에 따라 LOCOS(Local Oxidation of Silicon) 소자분리 방법은 베즈 빅(bird's beak)등에 의한 제약을 갖는다. 이러한 제약을 극복하기 위해 개발된 트렌치 소자분리 방법은 기판에 형성된 트렌치에 산화막을 채워넣는 방법을 사용한다.

한편 소자분리 특성을 만족시키기 위해서는, 비록 고집적화 요구에 따른 소자분리 영역의 폭 감소에도 불구하고, 적절한 트렌치 깊이의 유지를 요구한다. 그러나 이러한 요구는 트렌치 영역의 증횡비(aspect ratio) 증가를 초래하고, 이에 따라 트렌치 매립 공정에서 보이드(void) 등의 문제를 낳는다. 이를 해결하기 위한 공정의 하나가 2단계 소자분리막 적층에 의한 트렌치 매립 공정이다.

또한 트렌치에 의한 소자분리 공정에서 나타나는 실리콘 격자의 디스로케이션(dislocation)과 실리콘 기판의 산화에 따른 부피팽창에 의한 스트레스를 감소시키기 위해, 각각의 경우에 대해 열산화 공정과 실리콘질화막 라이너를 이용할 수 있다.

도 1, 도 2a 및 도 2b는 흐름의 자기정렬 트렌치 소자분리(이하 'SA-STI'라고 부르기로 한다) 방법을 설명하기 위한 단면도 등이다.

도 1을 참조하면, 반도체기판(11) 위에 차례로 적용된 터널 산화막(21), 도전막 패턴(12) 및 연마저지막 패턴(31)으로 구성된 트렌치 마스크 패턴을 형성한다. 상기 연마저지막 패턴(31)을 식각 마스크로 사용하여 상기 터널 산화막(21) 및 반도체기판(11)을 식각하여 트렌치 영역을 형성한다. 상기 트렌치 영역을 포함하여 반도체기판 전면에 걸쳐 제 1 소자분리막을 형성한다. 상기 제 1 소자분리막을 습식 식각의 방법으로 식각하여 트렌치 구조의 하부에만 존재하는 제 1 소자분리막 패턴(22)을 형성한다. 그런데 상기의 습식 식각 공정시 터널 산화막(21)이 도 1의 1과 같이 노출되고, 그 결과 상기 터널 산화막(21)은 상기 습식식각 공정에서 손상을 받게된다. 이러한 터널 산화막(21)에 대한 손상은 소자의 전기적 특성에 치명적 영향을 준다.

도 2a를 참조하면, 상기 도 1의 공정 단계 중 트렌치 영역 형성 단계와 제 1 소자분리막 패턴(22) 형성 단계 사이에 상기 반도체기판 전면에 걸쳐 실리콘질화막 라이너층(32)을 적용하는 단계를 더 포함한다. 이때 상기 실리콘질화막 라이너층(32)이 실리콘산화물 식각에 대해 둘은 선택비의 특성을 가지고 상기 제 1 소자분리막 패턴 형성시 진행되는 습식식각 공정을 진행할 경우 상기 식각 공정에 의한 터널 산화막(21)에의 손상을 방지할 수 있다. 상기 결과물을 포함하는 반도체기판 전면에 걸쳐 제 2 소자분리막을 형성한 후, 상기 연마저지막(31)이 노출될 때까지 CMP 등의 공정을 통해 제 2 소자분리막을 평坦화시킨다. 그 결과, 상기 연마저지막 패턴(31)과 상기 실리콘질화막 라이너(32) 각각의 상부면이 노출되고, 상기 제 1 소자분리막 패턴(22)상에 제 2 소자분리막 패턴(23)이 형성된다.

도 2b를 참조하면, 상기 연마저지막 패턴(31)의 제거를 위한 식각 공정에 의해, 상기 도전막(12)의 상부가 노출된다. 또한 상기 연마저지막 패턴(31)의 완전한 제거를 위한 과도식각이 요구되고 있는데, 이러한 요구는 도 2b의 2에서 보는 바와 같이 상기 제 2 소자분리막 패턴(23)과 도전막 패턴(12) 사이에 흰색 페인트는 아름바 덴트 현상의 한 원인이 된다. 상기 덴트 현상은 반도체 장치에서 브리지(bridge)와 같은 전기적 결합을 초래할 가능성이 때문에 바람직하지 않다.

발명의 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 자기정렬 트렌치로서 소자분리막을 형성하는 과정동안 터널 산화막에 대한 손상 및 덴트 현상을 방지하기 위하여, 소자분리막에 의해 매몰된 실리콘질화막 라이너를 가지는 자기정렬 트렌치 소자분리 구조체를 제공하는데 있다.

본 발명이 이루고자 하는 다른 기술적 과제는 소자분리막을 형성하는 과정동안 터널 산화막에 대한 손상 및 덴트 현상을 방지할 수 있는 자기정렬 트렌치 소자분리 구조체의 형성 방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은 SA-STI 구조체를 제공한다. 이 SA-STI 구조체는 반도체기판의 소정영역에 형성된 트렌치 영역 및 상기 트렌치 영역에 의해 한정된 활성영역을 포함한다. 상기 활성영역은 차례로 적용된 터널산화막 및 도전막 패턴에 의해 둘어진다. 상기 트렌치 영역의 대벽은 실리콘질화막 라이너에 의해 둘어지고, 상기 실리콘질화막 라이너에 의해 둘러싸여진 영역 및 상기 도전막 패턴들 사이의 갭 영역은 소자분리막에 의해 채워진다. 상기 소자분리막의 상부벽은 상기 도전막 패턴의 측벽들과 접촉한다. 따라서, 상기 실리콘질화막 라이너는 상기 소자분리막 및 상기 도전막 패턴에 의해 완전히 매몰된다.

바람직하게는, 상기 실리콘질화막 라이너 및 상기 트렌치 영역의 내벽 사이에 열산화막을 개재시킨다. 상기 열산화막은 상기 도전막 패턴 및 상기 소자분리막 사이의 영역까지 연장될 수도 있다.

상기 소자분리막은 상기 실리콘질화막 라이너에 의해 둘러싸여진 영역을 채우는 제 1 소자분리막 패턴 및 상기 제 1 소자분리막 패턴 상에 적용된 제 2 소자분리막 패턴을 포함한다.

상기 다른 기술적 과제를 달성하기 위하여 본 발명은 SA-STI 구조체의 형성 방법을 제공한다. 이 방법은 반도체기판 상에 트렌치 마스크 패턴을 형성한다. 상기 트렌치 마스크 패턴은 차례로 적용된 터널산화막, 도전막 및 연마저지막 패턴을 포함한다. 상기 연마저지막 패턴을 식각 마스크로 사용하여 상기 반도체기판을 식각하여 트렌치 영역을 형성한다. 상기 트렌치 영역 내에 제 1 소자분리막 패턴 및 상기 제 1 소자분리막 패턴을 감싸는 실리콘질화막 라이너를 형성한다. 상기 실리콘질화막 라이너는 상기 트렌치 영역의 내벽을 덮는다. 상기 제 1 소자분리막 패턴 상에 제 2 소자분리막 패턴을 형성한다. 상기 제 2 소자분리막 패턴의 상부벽은 상기 도전막 패턴의 측벽과 접촉한다. 따라서, 상기 실리콘질화막 라이너와 상기 연마저지막 패턴은 서로 마격된다. 여기서, 상기 제 1 소자분리막 패턴 및 상기 제 2 소자분리막 패턴은 소자분리막을 구성한다.

상기 제 1 소자분리막 패턴 및 상기 실리콘질화막 라이너를 형성하는 공정은 상기 트렌치 영역이 형성된 결과를 전면에 실리콘질화막 라이너층을 뿐포함하게 형성하고, 상기 실리콘질화막 라이너층 상에 제 1 소자분리막을 형성하는 것을 포함한다. 이어서, 상기 제 1 소자분리막을 식각하여 상기 트렌치 영역 내에 전존하는 제 1 소자분리막 패턴을 형성한다. 이때, 상기 연마저지막 패턴의 표면 상의 실리콘질화막 라이너를 및 상기 도전막 패턴의 측벽 상의 실리콘질화막 라이너층은 노출된다. 상기 노출된 실리콘질화막 라이너층을 식각하여 상기 트렌치 영역의 내벽을 덮는 실리콘질화막 라이너를 형성한다.

이에 대하여, 상기 실리콘질화막 라이너층을 형성하기 전에 상기 트렌치 영역이 형성된 결과물을 열산화시키어 상기 트렌치 영역의 내벽 및 상기 도전막 패턴의 측벽에 열산화막을 형성할 수도 있다. 상기 열산화막은 상기 트렌치 영역을 형성하기 위한 식각 공정을 실시하는 동안 반도체기판에 가해진 식각손상을 치유하기 위하여 형성된다.

계속하여, 상기 제 2 소자분리막 패턴을 형성한 후에, 상기 연마저지막 패턴을 제거하여 상기 도전막 패턴

특 2002-0074716

의 상부면을 노출시킨다. 이때, 상기 연마저지막 패턴이 상기 실리콘질화막 라이너와 동일한 물질막으로 형성될지라도 상기 실리콘질화막 라이너는 더 이상 삭각되지 않는다. 이는, 실리콘질화막 라이너가 상기 도전막 패턴 및 상기 소자분리막에 의해 덮여진 상태이기 때문이다. 따라서, 상기 실리콘질화막 라이너가 리세스되는 현상을 방지할 수 있다.

이하, 자기정률 트렌치 소자분리 방법을 설명하기 위한 단면도인 도 3 내지 도 9의 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명되어지는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 오히려, 여기서 소개되는 실시예는 개시된 내용이 협약하고 완전해질 수 있도록 그리고 당연자에게 본 발명의 사상이 충분히 전달될 수 있도록 하기 위해 제공되어지는 것이다. 도면들에 있어서, 흰색 영역들의 두께는 명확성을 기하기 위하여 과장되어진 것이다. 또 한 품이 다른 품 또는 기판 상에 있다고 언급되어지는 경우에 그것은 다른 품 또는 기판 상에 직접 형성될 수 있거나 또는 그들 사이에 제 3의 품이 개재될 수도 있다.

도 3를 참조하면, 반도체기판(110) 위에 차례로 적용된 터널 산화막(210), 도전막 및 연마저지막을 건식식각을 포함하는 패터닝으로 트렌치 마스크 패턴(50)을 형성한다. 상기 트렌치 마스크 패턴(50)은 도전막 패턴(120) 및 연마저지막 패턴(310)을 포함한다. 상기 도전막 패턴(120)은 물순물을 활용하는 폴리실리콘막으로 형성하는 것이 바람직하며, 상기 연마저지막 패턴(310)은 실리콘질화막으로 형성하는 것이 바람직하다.

도 4를 참조하면, 상기 트렌치 마스크 패턴(50)을 식각 마스크로 사용하여 상기 터널 산화막(210) 및 반도체기판(110)을 식각하여 소자분리막을 위한 트렌치 영역을 형성한다. 상기 트렌치 형성을 위한 식각 공정은 건식식각 풍선을 통해 이루어지며, 특히 식각에서 발생하는 폴리머를 이용하여 상부가 하부의 폭보다 넓은 형태의 트렌치를 형성하는 것이 이하 공정에서 진행될 트렌치 매립 특성의 형상을 위해 바람직하다. 또한 상기 트렌치 형성 후, 상기 트렌치 형성 공정에서 발생하는 반도체기판의 식각 손상을 치유하기 위하여 부가적으로 열산화막을 형성하는 열공정을 진행하는 것이 바람직하다. 상기 열공정의 결과, 트렌치 측벽의 열산화막(240)과 도전막 패턴(120) 측벽의 열산화막(250)이 형성된다. 상기 열산화막들(240, 250)은 실리콘질화막 라이너로부터 상기 도전막 패턴(120) 및 반도체 기판(111)을 미격시키는 기능을 마련하고, 이를 통해 실리콘질화막의 전자포획 특성으로 인한 반도체 소자의 전기적 특성을 물일 수 있다.

도 5를 참조하면, 상기 트렌치 영역을 포함하는 반도체기판 전면에 대하여 실리콘질화막 라이너층(320) 및 제 1 소자분리막(220)을 차례로 형성한다. 상기 실리콘질화막 라이너층(320)은 실리콘질화물을 CVD 방식으로 상기 트렌치 영역이 형성된 결과물 전면에 분포하게 형성하며, 제 1 소자분리막(220)은 전기적으로 절연 특성을 갖는 매립된 트렌치 구조를 목적으로 하는 것으로 산화막을 CVD 방식으로 적용하는 것이 바람직하다. 이 단계에서 상기 제 1 소자분리막(220)은 트렌치 전체를 완전히 채우지 않을 수도 있다.

도 6를 참조하면, 상기 제 1 소자분리막(220)을 전면 슬식 식각의 방법으로 리세스시켜 상기 트렌치 영역 내에 잔존하게 되는 제 1 소자분리막 패턴(221)을 형성한다. 앞서 중래기술(도 1 참조)에서 기술한 바와 같이 상기 식각 공정은 상기 터널 산화막(211)을 손상시킬 위험이 있었지만, 본 발명에서 상기 슬식 식각의 터널 산화막(211)에 대한 손상 위험은 상기 실리콘질화막 라이너층(320)이 실리콘산화물 식각 공정에서 높은 식각선택비를 가지고 높은 공정 조건을 진행함으로서 방지할 수 있다. 또한 리세스되는 깊이는 트렌치의 종횡비, 제 1 소자분리막의 끝과 그 두께 등을 고려하여야 하지만, 적어도 트렌치 영역 경계에서의 상기 연마저지막 패턴의 최하부(I)에 비해 낮도록 형성한다. 그 결과, 제 1 소자분리막이 리세스된 깊이만큼 실리콘질화막 라이너층(320)이 노출된다.

도 7를 참조하면, 상기 리세스 공정을 통해 노출된 실리콘질화막 라이너층(320)을 민산을 포함하는 슬식식각액으로 제거한다. 이에 따라 상기 리세스된 제 1 소자분리막(221) 위쪽의 실리콘질화막 라이너층은 모두 제거되어 실리콘질화막 라이너(321)를 형성한다. 상기 실리콘질화막 라이너(321)는 상기 트렌치 영역의 열산화막(240) 및 상기 터널 산화막(211)의 측벽을 덮고 상기 도전막 패턴 측벽의 열산화막(250)과 접촉한다. 그 결과, 상기 제 1 소자분리막 패턴(221)은 상기 실리콘질화막 라이너(321)에 의해 둘러싸여진다. 상기 실리콘질화막 라이너층의 제거를 위한 식각 공정은 건식 등방성 식각을 실시할 수 있으나 실리콘질화막 라이너층(320)의 적층형태와 식각 손상을 고려할 때 슬식식각을 사용하는 것이 바람직하다.

도 8를 참조하면, 상기 공정을 통해 형성된 결과물 전면에 상기 도전막 패턴(120)의 측벽과 접촉하면서 상기 제 1 소자분리막 패턴(221)을 모든 제 2 소자분리막을 형성한다. 그후, CMP 등의 방법을 통해 상기 연마저지막 패턴(310)이 노출될 때까지 상기 제 2 소자분리막을 평탄화시킨다. 그 결과로 도시한 바와 같이 리세스된 제 2 소자분리막 패턴(231) 및 리세스된 연마저지막 패턴(311)이 형성된다.

도 9를 참조하면, 상기 리세스된 연마저지막 패턴(311)을 전면 슬식 식각 공정을 통해 제거한다. 이때 상기 실리콘질화막 라이너(321)가 노출되지 않으므로 덴트 현상을 억제시킬 수 있다. 이때 상기 도전막 패턴(120)의 상부와 상기 제 2 소자분리막 패턴의 상부 사이의 최종 높이의 차이가 후속 공정의 어려움을 초래할 가능성이 있을 경우, 부가적으로 또는 상기 공정 중(예를 들면 상기 CMP 공정에서) 리세스된 제 2 소자분리막 패턴(231)의 높이를 낮추는 공정을 적용할 수 있다. 상기 식각 공정의 결과로 완만한 곡선 형태의 상부를 갖는 제 2 소자분리막 패턴(232)이 형성된다. 또한 더욱 완만한 상부면을 갖는 것이 후속 공정의 안정화를 위해 요구되어질 경우, 부가적인 공정을 실시할 수 있다.

도 10의 단면도를 통해, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 반도체 장치의 트렌치 소자분리 구조체를 설명한다.

도 10를 참조하면, 본 발명의 트렌치 소자분리 구조체는 반도체기판(111)의 소정영역에 형성된 트렌치 영역 및 상기 트렌치 영역에 의해 한정된 활성영역을 포함한다. 상기 활성영역은 차례로 적용된 터널산화막(211) 및 도전막 패턴(120)에 의해 덮여진다. 상기 트렌치 영역의 내벽을 실리콘질화막 라이너(321)에 의해 덮여지고, 상기 실리콘질화막 라이너에 의해 둘러싸여진 영역 및 상기 도전막 패턴들 사이의 경 영역은 소자분리막(260)에 의해 채워진다. 상기 소자분리막(260)의 상부 측벽은 상기 도전막 패턴(120)의 측벽들과 접촉한다. 따라서, 상기 실리콘질화막 라이너(321)는 상기 소자분리막(260) 및 상

2002-0074716

기 도전막 패턴(120)에 의해 완전히 막ируется.

비당직하게는, 상기 실리콘질화막 라이너(321) 및 상기 트렌치 영역의 내벽 사이에 열산화막(240)을 개재시킨다. 또한 상기 도전막 패턴(120) 및 상기 소자분리막(260) 사이에도 열산화막(250)이 개재될 수 있다.

상기 소자분리막(260)은 제1 소자분리막 패턴(221) 및 상기 제1 소자분리막 패턴(221) 상에 형성된 제2 소자분리막 패턴(232)을 포함한다. 상기 제1 소자분리막 패턴(221)은 상기 실리콘질화막 라이너(321)와 상기 제2 소자분리막 패턴(232)에 의해 막ируется. 또한 상기 제1 소자분리막 패턴(221) 및 제2 소자분리막 패턴은 CVD 산화막으로 구성된다.

설명의 흐름

본 발명에 따르면, 자기정렬 트렌치 소자분리막 형성을 위해 2단계 소자분리막 형성 과정이 적용될 때 발생하는 터널 산화막 손상의 문제를 실리콘질화막 라이너를 형성함으로써 해결할 수 있으며, 상기 실리콘질화막 라이너층이 자기정렬 트렌치 소자분리막 형성 과정에서 초래하는 덴트 현상을 실리콘질화막 라이너층을 2단계 소자분리막 형성 과정 중 일부 제거함으로써 방지할 수 있다. 그 결과, 터널 산화막과 관련된 물리적, 전기적 특성 및 웨드라인 간의 전기적 분리와 관련된 특성을 개선할 수 있다.

(5) 청구의 범위

청구항 1. 반도체기판 상에 차례로 적용된 터널산화막, 도전막 패턴 및 연마저지막 패턴으로 구성된 트렌치 마스크 패턴을 형성하는 단계;

상기 연마저지막 패턴을 식각 마스크로 사용하여 상기 반도체기판을 식각하여 트렌치 영역을 형성하는 단계;

상기 트렌치 영역의 내벽을 닦는 실리콘질화막 라이너 및 상기 실리콘질화막 라이너에 의해 둘러싸여진 영역을 채우는 제1 소자분리막 패턴을 형성하는 단계; 및

상기 제1 소자분리막 패턴 상에 적용된 제2 소자분리막 패턴을 형성하는 단계를 포함하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 2. 제1 항에 있어서,

상기 도전막 패턴은 실리콘막으로 형성하는 것을 특징으로 하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 3. 제1 항에 있어서,

상기 연마저지막 패턴은 실리콘질화막으로 형성하는 것을 특징으로 하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 4. 제1 항에 있어서,

상기 실리콘질화막 라이너 및 상기 제1 소자분리막 패턴을 형성하는 단계;

상기 트렌치 영역이 형성된 결과를 전면에 실리콘질화막 라이너층을 형성하는 단계;

상기 실리콘질화막 라이너층 상에 제1 소자분리막을 형성하는 단계;

상기 제1 소자분리막을 식각하여 상기 연마저지막 패턴의 표면 및 상기 도전막 패턴의 측벽 상의 상기 실리콘질화막 라이너층을 노출시킴과 동시에 상기 트렌치 영역 내에 잔존하는 제1 소자분리막 패턴을 형성하는 단계; 및

상기 노출된 실리콘질화막 라이너층을 식각하여 연마저지막 패턴의 표면 및 적어도 상기 도전막 패턴의 상부 측벽(Upper sidewall)을 노출시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 5. 제4 항에 있어서,

상기 실리콘질화막 라이너층을 형성하기 전에,

상기 트렌치 영역이 형성된 결과를 열산화시키며 상기 트렌치 영역의 내벽 및 상기 도전막 패턴의 측벽에 열산화막을 형성하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 6. 제1 항에 있어서,

상기 제2 소자분리막 패턴을 형성하는 단계;

상기 제1 소자분리막 패턴이 형성된 결과를 전면에 상기 도전막 패턴의 측벽과 접속하는 제2 소자분리막을 형성하는 단계; 및

상기 연마저지막 패턴이 노출될 때까지 상기 제2 소자분리막을 평탄화시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 7. 제1 항에 있어서,

상기 제2 소자분리막 패턴을 형성하는 단계 후에

상기 연마저지막 패턴을 제거하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 트렌치 소자분리 방법.

청구항 8. 반도체기판의 소정영역에 형성되고, 활성영역을 한정하는 트렌치 영역;

상기 활성영역 상에 차례로 적용된 터널산화막 및 도전막 패턴;

2002-0074716

상기 트렌치 영역 및 상기 도전막 패턴을 사이의 겹 영역을 채우는 소자분리막; 및
상기 트렌치 영역의 내벽 및 상기 소자분리막 사이에 개재되고, 그것의 양쪽단이 상기 도전막 패턴의 상부
면보다 낮은 실리콘질화막 라이너를 포함하는 소자분리 구조체.

청구항 9. 제 8 항에 있어서,

상기 실리콘질화막 라이너 및 상기 트렌치 영역의 내벽 사이에 개재된 윤산화막을 더 포함하는 것을 특징
으로 하는 소자분리 구조체.

청구항 10. 제 8 항에 있어서,

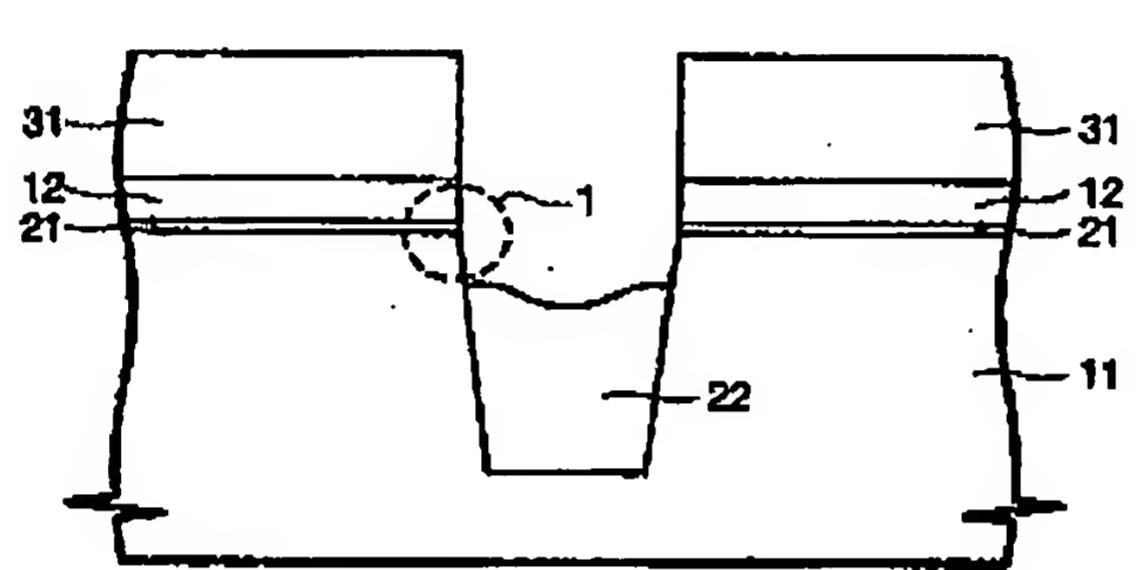
상기 소자분리막은

상기 실리콘질화막 라이너에 의해 둘러싸여진 영역을 채우는 제 1 소자분리막 패턴; 및

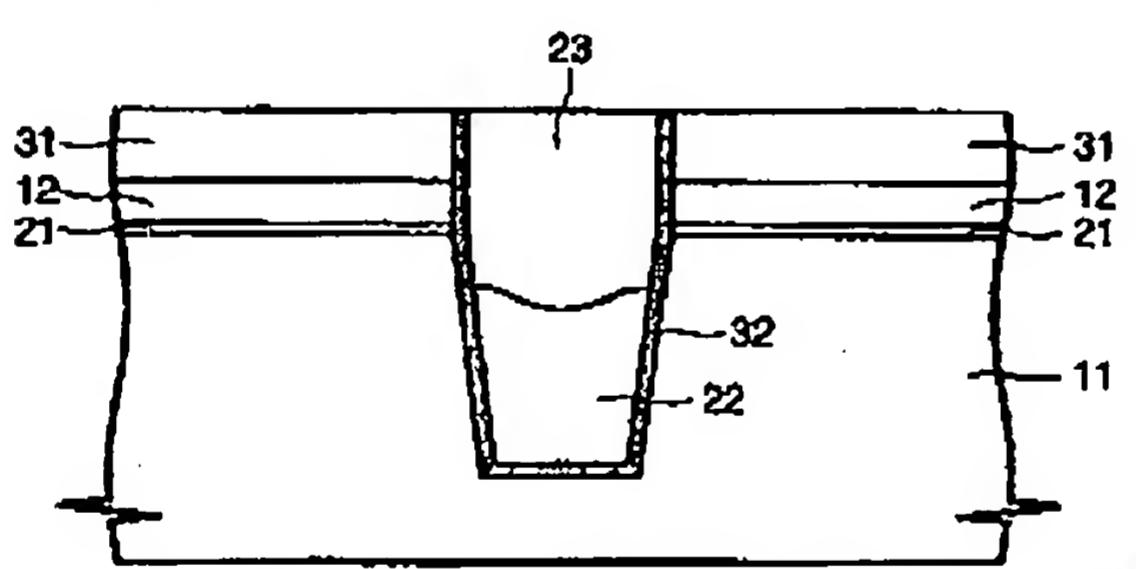
상기 제 1 소자분리막 패턴 상에 위치하고 상기 도전막 패턴의 육벽과 접촉하는 제 2 소자분리막 패턴을
포함하는 것을 특징으로 하는 소자분리 구조체.

도면

도면1

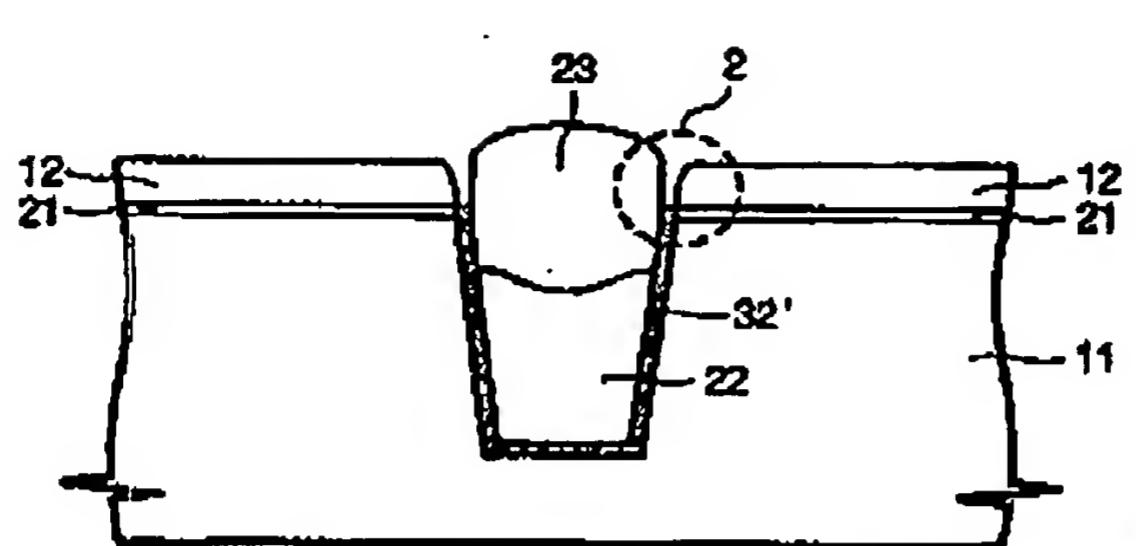


도면2

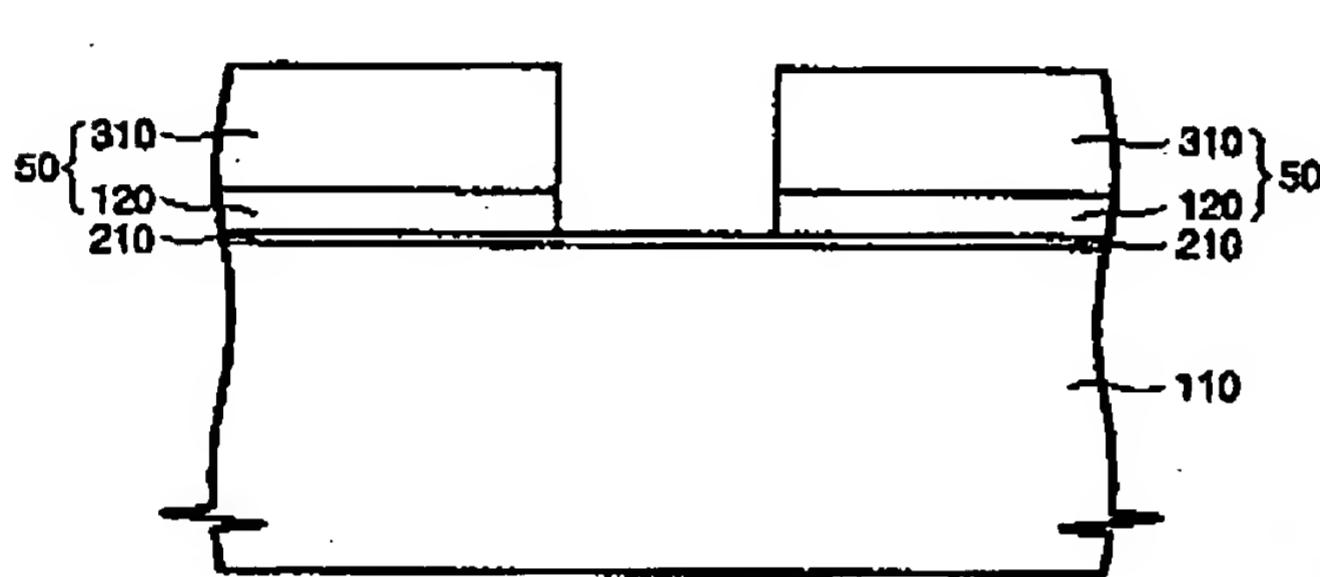


2002-0074716

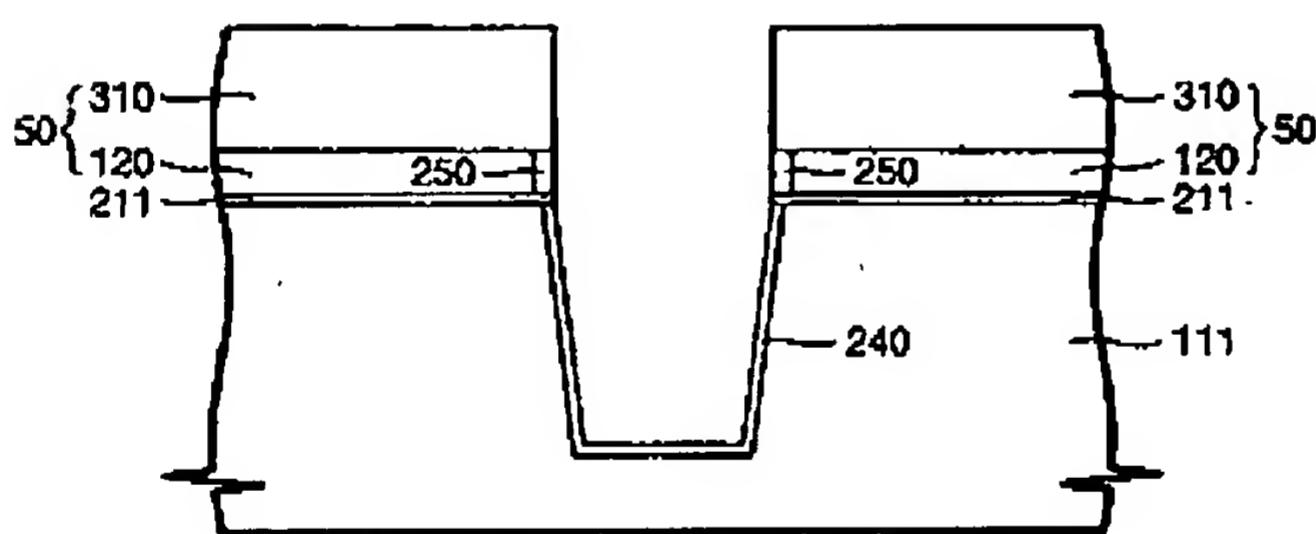
522



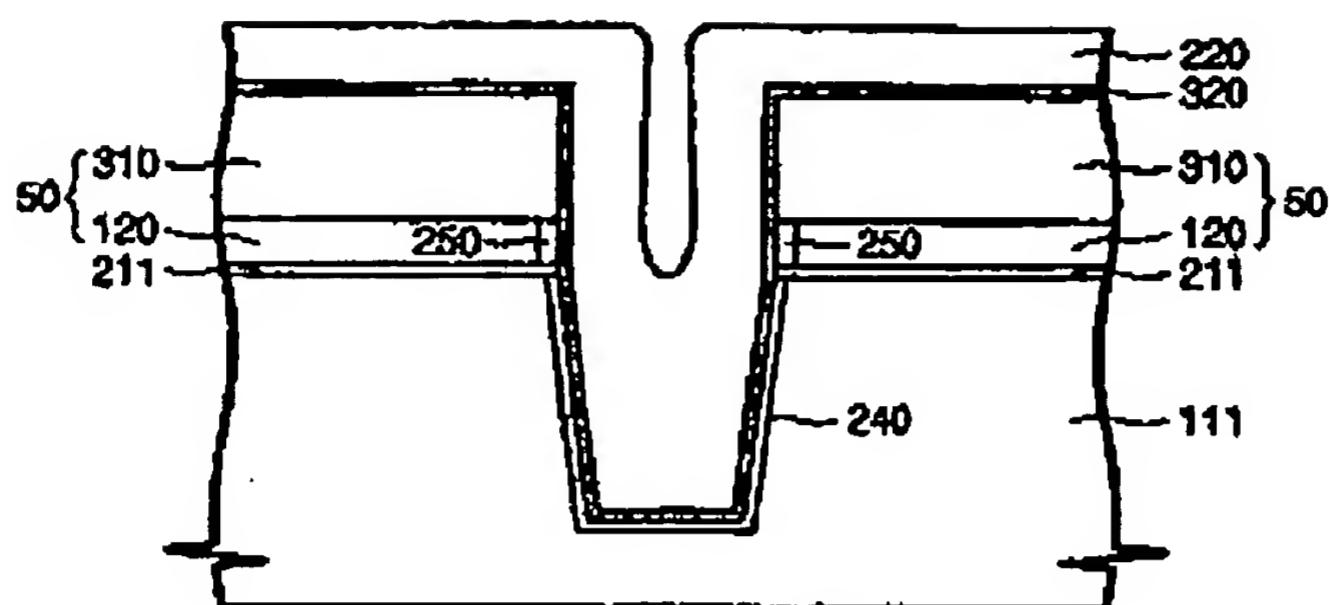
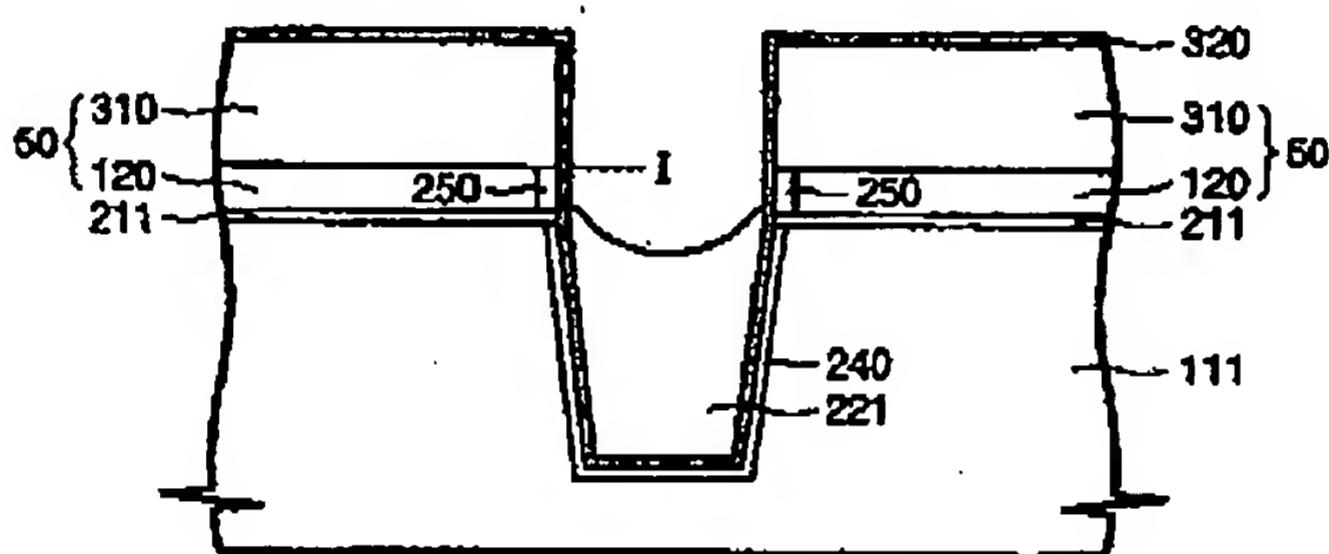
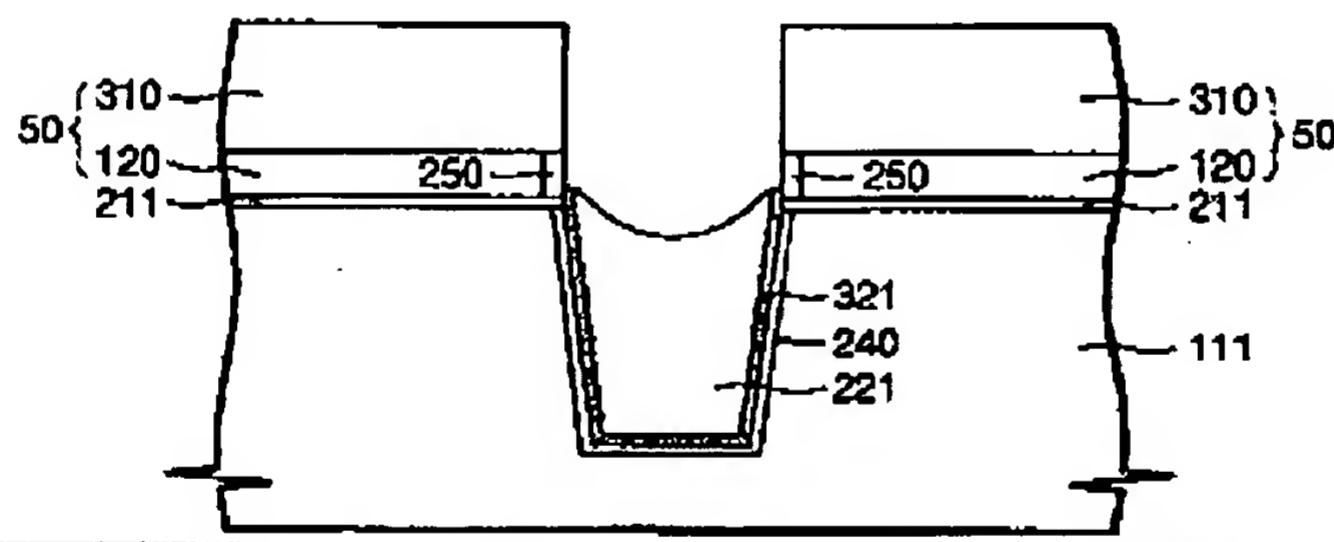
523



524

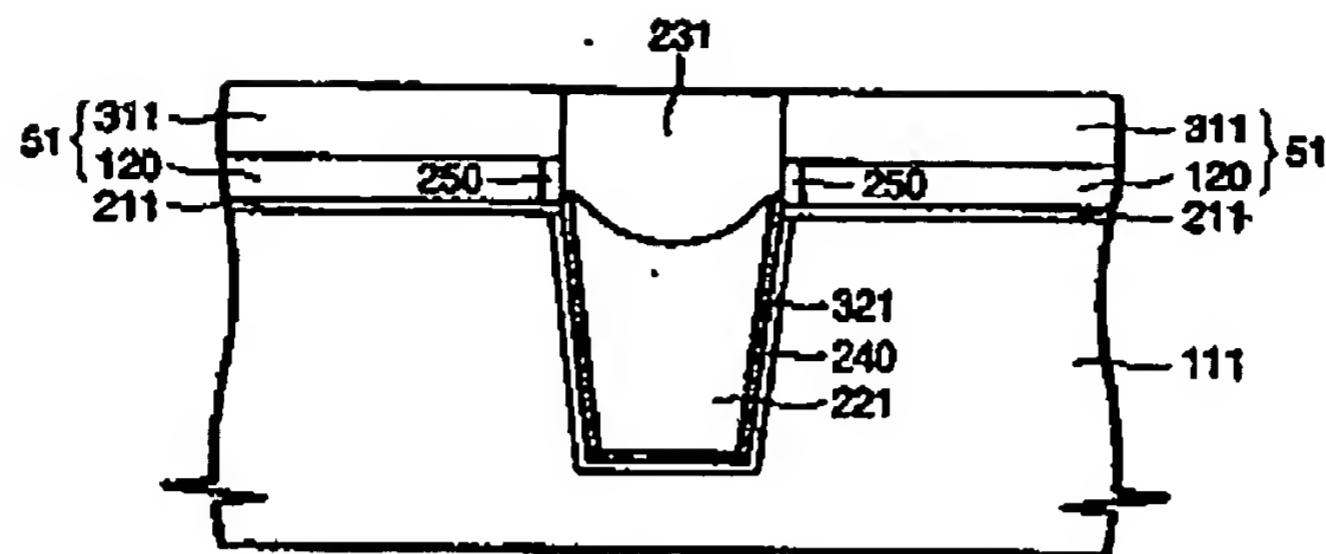


2002-0074716

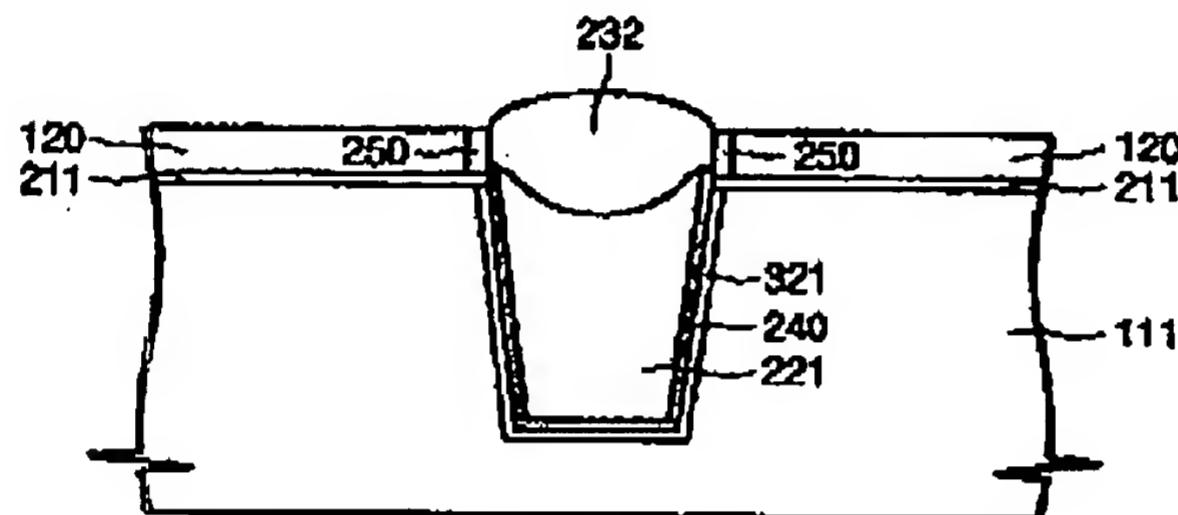
~~525~~~~526~~~~527~~

2002-0074716

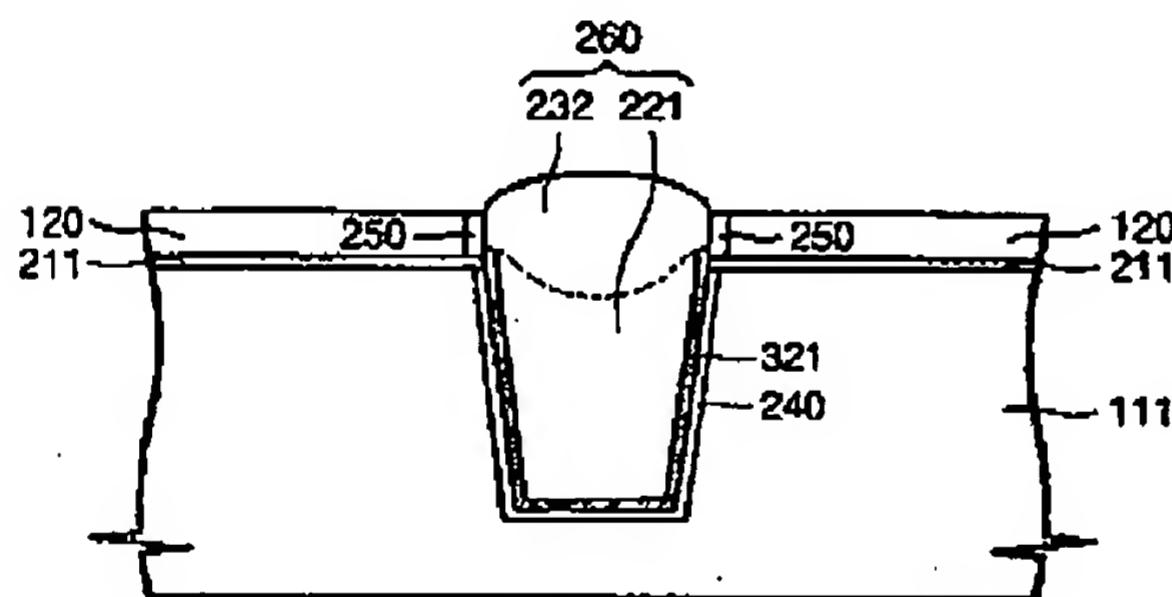
528



529



530



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.